

# 智能传感器展会-2024年大湾区传感器芯片博览会

产品名称	智能传感器展会-2024年大湾区传感器芯片博览会
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

## 产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会的成功举办，为全球半导体产业的发展注入了新的动力。通过这次展览会，参展商和观众得以近距离接触新的技术和产品，了解市场动态和应用前景。同时，也为国内外企业提供了一个交流与合作的平台，促进了国际间的合作与交流。在未来，随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，半导体产业将继续保持快速发展。我们期待着下一届展览会的到来，共同见证半导体产业的繁荣与发展。为了更好地推动全球半导体产业的发展，SEMI-e2024展览会将继续秉承“、创新、合作、发展”的理念，致力于为参展商和观众提供更优质的服务和更丰富的交流机会。

除了技术和产品展示外，展览会还举办了多场高峰论坛和技术研讨会。在高峰论坛上，来自全球各地的专家和学者就半导体产业的发展趋势、技术创新和市场应用等议题进行了深入探讨。他们认为，未来半导体产业将继续保持快速发展，同时面临着技术、市场和政策等多方面的挑战。因此，需要加强国际合作与交流，共同推动半导体产业的健康发展。

在未来的展览会上，我们将进一步加强技术交流和产业合作，鼓励创新和突破，促进半导体产业与各领域的融合发展。同时，我们也将关注人才培养和产业链完善，为产业的可持续发展提供有力支撑。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材)

Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等

5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等

6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等

7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等

8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等

9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等

10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等

11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等

12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等

13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

**开放共享 合作共赢**

开放带来进步，合作共享共赢！第六届展会将积极扩大“国际朋友圈”，吸聚国际资源，重磅推出展区。组委会将积极联通国内外市场，深度挖掘市场优势与需求潜力，让到场观众得以近距离感受国际较为前沿的、潮流的核心技术和产品，助力中国和全球市场双向对接。

在此，我们诚挚邀请国内外企业和专家学者积极参加下一届展览会，共同探讨半导体产业的未来发展方向，携手推动全球半导体产业的繁荣与发展。相信在各方的共同努力下，SEMI-e2024展览会将再次成为全球半导体产业界的盛会，为全球半导体产业的发展注入新的活力。